

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260402

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称 及人员姓名	社会公众投资者
时间	2026年4月2日下午 15:00-17:00
地点	微信小程序“投关易”
上市公司接待 人员姓名	公司董事长朱双全先生，董事、总经理朱顺全先生，董事、董事会秘书兼副总经理杨平彩女士，独立董事王雄元先生，董事、财务负责人姚红女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>业绩说明会就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：1.公司的晶圆光刻胶生产原料近期是否受到国际局势的干扰？ 2.公司的显示器件用光刻胶市场份额如何？是否面临价格竞争？谢谢！</p> <p>答：您好！感谢您对公司的关注。关于高端晶圆光刻胶，公司已实现其所需功能单体、主体树脂等核心原料的自主研发与制备，构建了稳定可控的上游原材料体系。该布局有效保障了核心原料的稳定供应，大幅降低了对外依赖风险，因此近期国际局势未对公司晶圆光刻胶生产原料造成影响。公司核心原料研发与自身光刻胶产品工艺高度匹配，在纯度控制、性能适配性等方面形成协同优势，为产品稳定生产与性能优化奠定坚实基础。关于 OLED 柔性显示用光刻胶，公司已成为国内主流显示面板厂客户核心供应商，国内市占率领先，具备较强的市场竞争力与客户黏性。从竞争格局来看，公司凭借在材料领域的技术积累、产品性能优势及与客户的深度合作，综合竞争力明显。公司始终以产品性能、成本控制与客户服务为核心，持续巩固并提升市场地位。</p> <p>问 2：1. 2026 年 CMP 抛光垫、抛光液的收入与增速指引是什么？产能利用率与扩产计划如何？ 2. 公司在主流晶圆厂的份额提升目标是什么，今年有望成为第一供应商的客户有哪些？ 3. 2026Q1 业绩高增，各业务板块贡献分别是多少？全年净利润是否有明确指引？</p>

答：尊敬的投资者：您好！感谢您对公司的关注。

1. 增速指引：公司 CMP 抛光材料为半导体核心耗材业务，2026 年将依托国内主流晶圆厂客户份额持续提升、全制程产品批量导入、海外市场逐步拓展三大核心驱动，维持收入快速增长态势。产能利用率：截至 2026 年一季度末，公司武汉本部 CMP 抛光硬垫月产能达 5 万片（年产约 60 万片），产能利用率随订单增长持续稳步提升；潜江园区抛光软垫及缓冲垫产能处于良性爬坡阶段，匹配下游精抛环节需求增长。抛光液与清洗液依托仙桃园区万吨级产线，产能利用率维持较高水平，保障核心客户稳定供应。扩产计划：公司正推进“光电半导体材料研发制造中心项目”，建设内容包含年产 40 万片大硅片抛光垫、4000 吨预聚体、200 吨微球发泡等配套产能，项目投产后将进一步完善 CMP 材料全产业链布局，满足大硅片、第三代半导体等新领域需求。未来公司将根据市场需求动态优化产能释放节奏。

2. 公司致力于持续提升在国内主流逻辑芯片、存储芯片制造厂商的供应份额，巩固 CMP 材料国产龙头地位，2026 年公司将重点深化客户端验证与产品渗透，助力中国半导体产业的发展。基于商业保密原则，具体客户名称不便披露，相关进展将通过业务经营成果体现。

3. 2026 年一季度公司预计归母净利润 2.4 亿元-2.6 亿元，业绩高增主要由半导体材料全业务线驱动。

公司 2026 年净利润以股权激励考核目标为核心导向：以 2023 年归母净利润为基数，净利润增长率目标值 350%（即 2026 年归母净利润目标值约 10 亿元）。公司将全力推进各业务板块产能释放与市场拓展，力争达成上述考核目标。

问 3：请问 25 年 cmp 抛光垫、抛光液及清洗液、半导体显示材料、先进封装材料的合作伙伴分别有哪些

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司半导体 CMP 制程工艺材料领域的 CMP 抛光垫、CMP 抛光液、清洗液客户主要为国内主流晶圆厂，半导体显示材料领域的 YPI、PSPI、TFE-INK 等产品的客户主要为国内主流显示面板厂，半导体先进封装材料的客户主要为国内主流封测厂。公司凭借产品优异的稳定性、安全性，以及服务的及时性、有效性，公司赢得下游客户广泛信任，与半导体行业下游客户建立起稳固、互利共赢的客情关系，为后续深化合作奠定坚实基础。客户的信任全力推动了新产品联合开发、验证评估进程，为已有产品逐步放量、结合客户反馈优化产品提供了坚实支撑，也为公司打造创新材料平台型企业、切入半导体材料领域其他关键新材料赛道，实现长期持续稳步发展筑牢了基础。

问 4：去年财务费用大幅增加，未来是否会降杠杆、优化债务结构、降低利息支出？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司 2025 年度财务费用增加主要系报告期内银行借款及公司发行可转债利息增加所致。未来，公司将通

过经营现金流偿还高息贷款、低息置换高息、推动可转债转股、严控新增债务等多种方式，稳步改善财务费用与杠杆水平。

问 5：你好，请问朱总，贵司筹划香港上市是基于什么考虑呢

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司目前正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市事项，系为深化公司在创新材料领域的全球化战略布局，加速海外业务拓展进程，提升公司品牌国际影响力和综合竞争力，同时搭建国际化资本运作平台，增强境外融资能力，助力公司高质量可持续发展，不断深化和拓展在半导体材料、面板显示材料及更高技术创新材料应用领域的竞争实力。

问 6：请问未来 1-2 年制约毛利率进一步提升的主要因素是什么？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司已量产的半导体材料产品具有一定的较强盈利能力，未来 1-2 年制约毛利率的主要因素有：潜江、仙桃产业园新产能转固折旧增加；研发持续高投入；高端晶圆光刻胶、先进封装材料等新品尚处投入期等。随着公司高毛利产品占比持续提升、结构优化及降本增效推进，中长期毛利率具备稳步提升的基础。

问 7：请问公司前五大半导体客户分别是哪些企业？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司半导体材料业务客户主要为国内主流晶圆制造厂商和显示面板厂商，基于商业保密原则及客户信息保护约定，具体客户名称不便披露，请您理解。

问 8：您好，请问朱总，公司潜江二期 300 吨 KrF/ArF 光刻胶量产线已建成，产能爬坡进度如何？预计下半年贡献多少收入？已有 3 款批量供货产品，订单可见度多高？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司二期年产 300 吨 KrF/ArF 高端晶圆光刻胶量产线的主体厂房及配套设施均已建成，成为国内首条“有机合成-高分子合成-精制纯化-光刻胶混配”全流程的高端晶圆光刻胶量产线，产线对标国际一流，实现高度自动化、信息化，同步完成产线与控制系统数据库搭建及 AI 分析赋能，大幅提升研发转化效率，有力推动光刻胶产品从实验室成果向规模化稳定量产的高效转化。此外，公司 ArF、KrF 光刻胶产品已有 3 款产品进入稳定批量供应阶段，超 12 款进入加仑样测试阶段，验证进展顺利。公司今年将持续做好高端晶圆光刻胶业务的市场推广和生产上量工作，努力推动高端晶圆光刻胶产品收入增长。

问 9：公司 2025 年新增半导体客户数量及验证通过转量产的数量请问是多少？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。2025 年公司半导体材料新增客户及验证转量产数量均实现稳步增长，多款核心产品在多家晶圆厂、面板厂完成认证并批量供货。因客户名单涉及商业敏感信息，不便披露，感谢您的关注。

问 10：请问公司 cmp 抛光垫是否有扩产计划？扩产周期需要多久？公

司是否有开拓其他 cmp 化学品业务的计划？

答：您好！感谢您对公司的关注。公司 CMP 抛光垫业务已制定明确、循序渐进的扩产规划，均基于下游晶圆厂扩产、国产替代深化及订单增长需求的前瞻性布局。其中武汉本部抛光硬垫产线截至 2026 年一季度末，已完成产能提升，月产能达 5 万片（年产约 60 万片），当前产能利用率随订单增长持续提升，可充分满足现有及短期增量订单需求。关于大硅片专用抛光垫产能，公司正建设光电半导体材料研发制造中心项目，包含新增 40 万片/年大硅片抛光垫产能，重点适配大尺寸硅片、第三代半导体等新兴领域需求，进一步完善产品矩阵与产能结构。软垫及配套产能：潜江园区已具备年产 20 万片抛光软垫及配套缓冲垫产能，当前处于有序爬坡阶段，同步匹配先进封装、大硅片等细分领域需求增长。

未来，公司将持续以技术研发为核心、客户需求为导向，稳步拓展 CMP 核心材料矩阵，提升系统化供应与服务能力。相关业务进展请以公司定期报告及临时公告为准。

问 11：公司打印耗材业务毛利率回升，是产品提价、结构优化、原材料降价还是其他因素驱动？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司综合毛利率提升主要得益于半导体材料业务规模持续扩大、高毛利产品占比提升，以及公司耗材产品结构优化、成本管控与运营效率改善等多重因素共同推动。

问 12：请问一季度业绩预告中的利润，有没有包含皓飞的利润？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。公司一季度业绩增长主要系半导体材料业务营业收入稳步增长。皓飞新材自 3 月起纳入合并范围，将对二季度利润产生积极贡献。

问 13：公司年报中提到 2025 年首次实现抛光垫单月销量破 4 万片的历史新高，那 2026 年一季度的销量怎么样？目前的产能能否支撑？

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。2026 年一季度公司抛光垫销量保持增长、态势良好。武汉本部抛光硬垫产线产能已达到月产 5 万左右（即年产约 60 万片），叠加潜江产业园软垫产能，当前产能利用率维持在良好水平，可充分支撑业务发展。

问 14：公司 2025 年半导体材料整体收入占比已超 57%，其中CMP 抛光垫、抛光液、显示材料、先进封装材料各自收入、增速、毛利率分别是多少？**

答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。2025 年度公司半导体材料各细分业务经营情况如下：①CMP 抛光垫业务：实现销售收入 10.91 亿元，同比增长 52.34%；其中四季度销售收入 2.96 亿元，同比增长 53.40%。②CMP 抛光液及清洗液业务：实现销售收入 2.94 亿元，同比增长 36.84%；其中四季度销售收入 9,132 万元，同比增长 21.72%。③半导体显示材料业务：实现销售收入 5.44 亿元，同比增长 35.47%；其中四季度销售收入 1.31 亿元，同比增长 9.14%。④半导体先进封装材料业务：2025 年销售收入 1,176 万元。

其他详细经营信息请您查阅公司 2025 年度报告。

问 15: 在半导体显示材料方面, 年报提到仙桃产业园年产 1,000 吨 PSPI 产线已顺利投产并实现稳定批量供货, 仙桃年产 800 吨 YPI 二期项目已如期完工并进入试运行阶段, 那目前的产能能否满足销量增长需求?

答: 尊敬的投资者: 您好! 感谢您对公司的关注。公司目前仙桃产业园 PSPI、YPI 现有产能整体能够匹配当前下游客户订单及销量增长需求, 产线运行稳定, 可保障主流面板客户的规模化、连续性供应。其中, 年产 1,000 吨 PSPI 产线已实现稳定批量供货, 产能利用率随订单增长保持在合理水平; 年产 800 吨 YPI 二期项目已完工进入试运行, 正有序开展工艺优化与产能爬坡, 进一步补充了 YPI 产品的供应能力, 有效缓解了前期产能偏紧的状况, 为后续柔性 OLED 市场需求增长预留了充足弹性空间。

公司将根据下游显示行业景气度、客户扩产节奏及订单增量情况, 动态优化产能释放节奏, 并持续推进产线智能化升级与效率提升。若未来市场需求出现超预期增长, 公司将结合整体规划适时研究后续产能布局, 确保供应安全稳定。

问 16: 大硅片抛光垫、碳化硅为代表的化合物半导体用抛光垫等市场推进进展怎么样?

答: 尊敬的投资人您好, 感谢您的提问。公司积极拓展大硅片、第三代半导体、先进封装等新领域市场, 成功切入并获取订单, 产品应用场景持续拓宽。

问 17: 请说明下铜及铜阻挡层抛光液、金属栅极(钨、铝)抛光液、浅槽隔离抛光液、多晶硅、氮化硅等抛光液以及清洗液到目前为的订单落地、客户端推进情况。

答: 尊敬的投资人您好, 感谢您的提问。2025 年, 公司 CMP 抛光液、清洗液业务累计实现产品销售收入 2.94 亿元, 同比增长 36.84%; 其中, 第四季度实现产品销售收入 9,132 万元, 同比增长 21.72%。CMP 抛光液产品中铜及铜阻挡层、金属栅极(钨、铝)、浅槽隔离等新品类不断突破, 多晶硅、氮化硅等品类持续稳步放量。核心原材料研磨粒子自主供应链优势持续巩固, 搭载自产四大体系研磨粒子(超纯氧化硅溶胶、高纯氧化硅溶胶、氧化铝、氧化铈)的抛光液产品市场接受度稳步提升, 为产品市场拓展与产能释放提供坚实支撑。铜及铜阻挡层抛光液, 搭载自主化氧化硅研磨粒子等核心原材料, 产业化推进成效显著。2025 年, 相关产品实现首次订单落地, 多款产品在客户端持续稳定上量, 另有多款产品在客户端加速导入中。金属栅极(钨、铝)抛光液, 依托自主化氧化铝研磨粒子等核心原材料, 客户认可度与需求度持续提升。存量客户端供应量稳定扩增, 并不断有新型号产品通过验证并持续上量。浅槽隔离抛光液, 采用自主化氧化铈研磨粒子等核心原材料, 在客户端验证实现重大突破, 多款产品验证顺利并进入收尾阶段, 为后续订单拓展奠定坚实基础。多晶硅、氮化硅等抛光液, 存量客户用量持续提升, 同时积极配合客户工艺需求开发定制化产品, 围绕研磨粒子性能优化与化学配方升级双向发力, 相关产品品类已稳居国内领先地位。

	<p>问 18：请说明下半导体封装 PI、临时键合胶、高端晶圆光刻胶到目前为止的订单落地、客户端推进情况。</p> <p>答：尊敬的投资人您好，感谢您的提问。2025 年度，公司半导体先进封装材料产品实现销售规模快速提升，整体业务迈入稳步放量新阶段，新产品验证导入与市场推广成效显著。半导体封装 PI 方面，公司已布局 7 款产品，目前共有 2 款产品取得多家客户订单，在售型号数量及覆盖客户范围持续扩大，订单增长动能进一步增强。临时键合胶方面，在已有客户实现稳定规模出货的同时，成功取得新客户订单突破，市场拓展与产品应用持续深化。2025 年，半导体先进封装板块整体销售额突破千万元大关，业务规模实现跨越式提升。此外，公司持续推进重点产品在国内各主流封测厂客户的验证导入，积极开拓新的重点客户群体，不断拓宽业绩增长空间与产品布局边界，为半导体先进封装材料业务长期发展奠定坚实基础。</p> <p>在高端晶圆光刻胶业务方面，公司浸没式 ArF 及 KrF 晶圆光刻胶业务稳步推进、加速突破，在国内实现“全制程”与“全尺寸”覆盖。产品开发及市场拓展方面，公司已布局超 30 款高端晶圆光刻胶，超 20 款产品完成客户送样验证，其中超 12 款进入加仑样测试阶段，验证进展顺利。已有 3 款产品进入稳定批量供应阶段，同时成功开拓多家新客户并同步开展产品验证，客户结构持续优化，商业化进程显著加快。具体情况可关注公司公开披露的《2025 年年度报告》。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 4 月 2 日